

Министерство науки, высшего образования и технической  
политики РСФСР

Московский орденов Ленина, Октябрьской революции и Трудового  
Красного Знамени государственный технический университет  
имени Н.Э.Баумана

Д. В. Иванов

ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПАЙКИ  
МИКРОСХЕМ

Лабораторная работа

Учебное пособие по курсу "Технология РЭС и ЭВС"

Данное учебное пособие издается в соответствии с учебным  
планом. Рассмотрено и одобрено решением кафедры ИУ-4  
" " " 1989 г и методической комиссией факультета ИУ  
МГТУ им. Н.Э.Баумана

Рецензент

проф., д.т.н. Ю.И.Нестеров

### Оглавление

Введение  
Цель работы, объект исследования  
Используемое оборудование и приборы  
Краткое содержание работы и порядок выполнения  
Содержание отчета  
Теоретическая часть  
Методика эксперимента  
Контрольные вопросы  
Литература

Редактор

Корректор

Завед.

Объем

Тираж 300 50 экз.

Типография ИИЭМ

121471, Москва, ул., Бережковская, д. 41

паяного соединения.

5. Как подготавливаются компоненты (платы и ИС) к пайке.
6. Какие режимы операции "пайка ИС" Вы знаете.
7. Как влияет усилие прижима ИС на процесс автоматизированной пайки.
8. Как регулируется величина прижима ИС.
9. Как влияет температура паяльника на процесс автоматизированной пайки.
10. Как регулируется величина температуры паяльника.
11. Как влияет время выдержки паяльника в зоне пайки на процесс пайки.
12. Как влияет величина навески припоя на процесс пайки.
13. Как регулируется величина навески припоя.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Курс лекций по разделу "Электрический монтаж в производстве РЭА" курса "Технология РЭС".
2. Иванов-Осипович Н.К. Физико-химические основы производства РЭА. - М.: Высшая школа, 1979.
3. Ханке Х., Фабиан Х. Технология производства РЭА. - М.: Энергия, 1980.
4. ОСТы и ТУ на подготовку микросхем в корпусе 40I.14.
5. Паспорт и инструкция по эксплуатации автомата раскладки и пайки микросхем.